

先端パッケージングの 未来を、めっきで支える。

Advanced Electroplating Solutions
for Next-Generation Packaging

TSV | RDL | マイクロバンプ | 微細配線



大型角基板対応
開発機

Large Panel Plating Tool

対応めっき種

Plating Materials



Cu



Ni



Au



SnAg



Rh



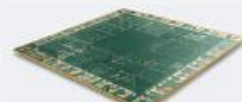
磁性材料

対応基板

Substrates



Wafer
小片 ~ $\phi 300$ mm



Panel
Max. 600 × 600 mm

めっきデモ

プロセスサポート

東京オフィス：〒190-0023東京都立川市柴崎町3-6-19勇和ビル2階
TEL：042-519-3037 / Email：info@tosetz.com

<https://www.tosetz.com> ▶



株式会社 東 設
Zosetz
Safety & Reliability